公司代码:688432 公司简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.55元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。本次利润分配方案尚需经股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	有研硅	688432	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨波	孙妮
联系地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电话	010-82087088	010-82087088
传真	010-62365381	010-62365381
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

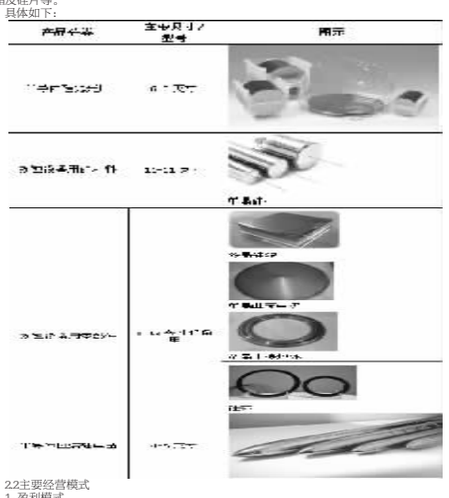
1、主要业务

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料,刻蚀设备用零部件、半导体区熔硅单晶及硅片等。产品主要用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、刻蚀设备等,并广泛应用于智能制造、新能源汽车、航空航天等领域。

2、主要产品

公司主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、刻蚀设备用零部件、半导体区熔硅单晶及硅片等。

具体如下:



2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片、向下游刻蚀设备部件制造企业销售刻蚀设备用硅单晶等产品实现收入和利润。

2、采购模式

为保证公司原辅材料的高质量和稳定性,公司建立了严格的供应商管理制度,对供应商实行严格认证。根据供应商的资质条件、产品质量、技术实力、供货能力、服务水平、财务状况等情况对供应商进行综合评价,将符合条件的供应商纳入合格供应商范围进行采购。对合格供应商定期审核评估,并确保主要原辅材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

3、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,紧密围绕客户差异化需求开展产品工艺设计与定制化生产。国内、海外两大市场部基于深入的市场调研与客户需求制定销售计划;生产管理部根据市场部提供的市场需求预测编制年度生产规划,并根据实际客户订单动态调整与细化月度生产计划;技术研发部依据生产计划,制定并审核产品技术规范;制造部则按照生产计划与技术规范,统筹调配生产资源,确保按期完成生产任务。

公司建立了覆盖全流程的质量管控体系,对生产各环节实施严格的测试与检验,确保公司产品品质可靠。凭借在技术研发与生产管理领域的深厚积淀,公司依托SAP管理系统、MES生产管理系统和WMS仓储管理系统等信息化平台,实现对产品开发、原材料采购、生产制造与质量检验、出入库、销售服务全业务流程的标准化管控。同时推行精益生产模式,该模式有力保障了产品质量的稳定性和一致性,相关质量指标居于国内行业领先水平。

4、销售模式

报告期内,公司构建以直销为核心,辅以少量经销与代理的多元化销售体系。直销模式下,公司直接对接下游客户并签订购销合同,开展产品销售;经销模式下,公司将产品售予贸易商,由其分销至终端用户;代理模式下,公司直接与终端客户签订销售协议并履行产品交付义务,公司依据合作协议约定向其支付代理佣金。公司产品定价方面,公司以市场化价格为基准,综合考量市场供需格局、客户定制化需求参数、公司产能承载能力及交易结算条款等多重因素,实施灵活的差异化定价策略。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

全球半导体硅片行业正处于一个结构性分化的复苏与转型阶段。整体来看,市场已走出2023年的周期性底部,但复苏动力高度集中在以人工智能(AI)驱动的先进制程领域,而成熟制程市场则呈现温和且缓慢的复苏态势。全球半导体硅片市场仍由五大厂商(日本信越、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国世创、韩国SK siltron)主导,中国大陆正加速追赶,在自主可控战略驱动下,本土企业正加速产能扩张和技术攻关。

(2)基本特点

一是行业周期性强。半导体硅片行业景气度与全球半导体行业周期紧密绑定,供需失衡时常导致价格剧烈波动。二是资本与技术双密集型。生产设备价格高,所需投资规模巨大,并且随着技术的进步,客户的需求不同,还需要对生产设备不断进行改造和升级,需要大量的运转资金。同时,研发生产过程涉及微电子学、半导体物理学、材料学等诸多学科,需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。三是行业准入壁垒高,客户认证极其严格和漫长,通常需1-3年方可完成全面认证,但是一旦通过会形成较为稳定的供应链绑定关系。

(3)主要技术门槛

半导体硅片制造核心工艺包括单晶生长和硅片精密加工。硅单晶生长核心技术主要包括热场设计、掺杂技术、磁场技术、氧浓度控制等,硅片精密加工技术主要包括硅片厚度变化、硅片翘曲、硅片弯曲、表面局部平整度、硅片表面粗糙度、硅片几何参数及硅片表面的超洁净控制;刻蚀设备用硅材料及零部件核心指标包括缺陷密度、杂质含量、电阻率范围及分布均匀性等。工艺技术水平决定了产品良品率和参数一致性。上述指标随着集成电路制程的不断进步愈发严格,对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内半导体硅材料龙头企业,是国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等研发及创新平台,是集成电路关键材料国家工程研究中心依托单位。公司是中国半导体行业协会常务理事单位、中国电子材料行业协会副理事长单位、中关村集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位、北京半导体行业协会常务理事单位、中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位。

公司坚持创新驱动发展战略,坚持以市场为导向,加快从“硅材料细分领域龙头”向“半导体核心材料与部件综合供应商”演进,不断优化产业布局,持续保持核心优势的稳固,行业影响力不断增强。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新技术方面,呈现“超越摩尔”与“扩展摩尔”并进的发展态势。一方面,硅基材料通过SOI、应变等技术持续演进;另一方面,硅片作为“平台”,与第三代半导体(SiC/GaN-on-Si)、光电子等异构集成,打开新空间。

新产业方面,形成了“一体两翼”的产业发展格局。以先进逻辑用大硅片为主体,以“特色材料(SOI、功率等)和“先进封装材料”为两翼,共同驱动增长。

新业态方面,“全球化分工”与“区域化集群”长期共存。既有遵循效率的全球产业链,也有基于安全的区域闭环,中国、美国、欧洲等地的本地化供应链将初步成形。

新模式方面,半导体硅片行业的竞争逻辑已从产能与成本竞争,转向“尖端技术+客户生态+可持续性”的综合竞争。能否进入最先进制程的研发循环,并提供全生命周期解决方案,将成为关键分水岭。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	549,445.93	536,776.84	2.36	504,305.63
归属于上市公司股东的净资产	452,081.87	434,158.70	4.13	414,799.84
营业收入	100,524.57	99,594.59	0.93	96,040.33
利润总额	28,720.29	31,829.33	-9.77	32,440.99
归属于上市公司股东的净利润	20,928.06	23,290.38	-10.14	25,418.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,962.48	16,302.23	-20.55	16,500.37
经营活动产生的现金流量净额	27,419.07	22,936.80	19.54	26,664.28
加权平均净资产收益率(%)	4.75	5.51	减少0.76个百分点	6.23
基本每股收益(元/股)	0.1682	0.1871	-10.10	0.2037
稀释每股收益(元/股)	0.1682	0.1871	-10.10	0.2037
研发投入占营业收入的比例(%)	9.19	7.86	增加1.33个百分点	8.56

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	23,082.44	26,009.06	25,565.14	25,867.93
归属于上市公司股东的净利润	4,907.99	5,696.48	5,008.33	5,316.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,426.30	3,930.24	2,561.85	3,034.09
经营活动产生的现金流量净额	6,910.48	7,753.93	5,439.85	7,314.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,647
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京有研芯斯半导体科技有限公司	0	384,750,000	30.77	0	无	0	境内非国有法人
株式会社RS Technologies	0	327,090,400	26.16	0	无	0	境外法人
中国有研科技集团有限公司	0	230,422,500	18.43	0	无	0	国有法人
福建仓元投资有限公司	0	28,215,000	2.26	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	15,418,353	17,430,476	1.39	0	无	0	其他
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	0	14,319,986	1.15	0	无	0	其他
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	0	8,559,963	0.68	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	424,606	8,488,857	0.68	0	无	0	其他
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳第四投资合伙企业(有限合伙)	-8,851,434	5,427,255	0.43	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,121,135	4,307,290	0.34	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研芯斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、株式会社RS Technologies与福建仓元投资有限公司签署一致行动协议。 3、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

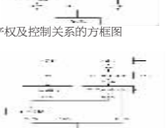
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

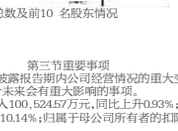
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业总收入100,524.57万元,同比上升0.93%;实现归属于母公司所有者的净利润20,928.06万元,同比下降10.14%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润12,962.48万元,同比下降20.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-011

有研半导体硅材料股份公司 2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.55元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币197,105,335.49元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,250,301,858股,扣除回购股份3,555,336股,以此计算本次拟派发现金红利68,571,058.71元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的32.77%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

单位:人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	68,571,058.71	74,643,943.32	87,297,920.70
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,280,637.60	232,903,753.41	254,181,046.52
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	197,105,335.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	230,512,922.73		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	232,121,812.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	230,512,922.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	99.31		
现金分红比例(R)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	252,917,140.92		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	2,961,594,896.65		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	8.54		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营发展产生不利影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年3月27日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-018

有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月28日14点00分

召开地点:北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月28日

至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案	√
6.01	与RST及其同一控制下的交易	√
6.02	与中国有研及其同一控制下的交易	√
6.03	与山东有研艾斯的交易	√
6.04	与恒圣石墨及其同一控制下的交易	√
7.00	关于修订部分治理制度的议案	√
7.01	董事薪酬管理制度	√
8	关于公司购买董责险的议案	√
9	关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案	√

注:本次股东会将分别听取四位独立董事《2025年度独立董事述职报告》及公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2025年10月28日及2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:株式会社RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研芯斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

5、涉及优先股或表决权恢复的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2026/4/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2026年4月26日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱gritekipo@gritek.com进行预约登记;信函预约的以收到邮戳为准,信函上请注明“股东会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明(身份证件)、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1);

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因本按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式

地 址:北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编:100088

联系人:孙媛

电 话:010-82087088

电子邮箱:gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年3月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2025年年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年年度利润分配预案的议案			
4	关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
6.00	关于公司2025年年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案			
6.01	与RST及其同一控制下的交易			
6.02	与中国有研及其同一控制下的交易			
6.03	与山东有研艾斯的交易			
6.04	与恒圣石墨及其同一控制下的交易			
7.00	关于修订部分治理制度的议案			
7.01	董事薪酬管理制度			
8	关于公司购买董责险的议案			
9	关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-017

有研半导体硅材料股份公司 关于购买董责险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司购买董责险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,降低公司治理和运营风险,保障广大投资者利益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险(以下简称“董责险”)。

现将相关情况公告如下:

一、董责险方案

1.投保人:有研半导体硅材料股份公司

2.被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员等(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3.赔偿限额:不超过人民币5,000万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

4.保险费用:不超过人民币20万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)

5.保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)

二、授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进一步授权公司经营层,具体办理公司董责险购买的相关事宜(包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员;确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;如市场发生变化,则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜,续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

三、履行的程序

2026年3月25日,公司召开第二届董事会薪酬和考核委员会第六次会议、第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司购买董责险的议案》。根据相关法律法规的规定,以及基于谨慎性原则,因该事项与公司董事存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体薪酬和考核委员会委员、全体董事对本议案回避表决,议案将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年3月27日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-014

有研半导体硅材料股份公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	180,000.00万元
投资种类	安全性高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,包括结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:2026年3月25日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:尽管公司购买安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率,增加公司收益和股东回报。在确保自有资金安全和不影响日常公司生产经营的情况下,公司拟使用自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币180,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,单笔投资期限不超过一年。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

1.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月(含)的保本理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品),具体合同条款以实际签署合同为准。上述交易不构成关联交易。

2.实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择专业金融机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。

3.信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

(五)投资期限

本次投资期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过180,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品)。使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内,单笔投资期限不超过一年。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次对闲置自有资金进行现金管理是投资于安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的投资品种。公司财务部相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司使用自有资金进行现金管理能够有效提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年3月27日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2026-015

有研半导体硅材料股份公司 关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币210,000.00万元综合授信额度。现将相关情况说明如下:

为保障公司2026年度经营发展的需要,2026年度,公司及子公司拟向相关金融机构以信用方式申请合计不超过人民币210,000.00万元的综合授信额度。

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需,包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度明细如下:

序号	公司名称	授信银行	拟授信额度(万元)
1	有研半导体硅材料股份公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	50,000.00
2	有研半导体硅材料股份公司	兴业银行股份有限公司 北京分行	50,000.00
3	有研半导体硅材料股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	30,000.00
4	有研半导体硅材料股份公司	中信银行股份有限公司 北京分行	20,000.00
5	有研半导体硅材料股份公司	招商银行股份有限公司 北京分行	10,000.00
6	山东有研半导体材料有限公司	中信银行股份有限公司 北京分行	30,000.00
7	山东有研半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	20,000.00
合计			210,000.00

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在